

## LaserTech 2013

### ウルトラファーストレーザ



米国産業用規格をパスした、Up Tek Solutions社の産業／理科学用ウルトラファーストレーザ及び固体レーザ。

本システムは、産業用対応で24時間/7日間を完全無停止状態で安定に動作できるシステムを提供。主にダイヤモンド・超硬材・セラミックなどの加工穴あけや高精度位置・姿勢センサーエレメントのトリミングなどに最適。特にウルトラファーストでの加工は後工程処理を省略できるメリットがある。

同社の製品は日本で初めての販売。

AkiTech LEO株式会社 営業部  
e-mail: info@akitechleo.com  
ブース番号: T-092

### 50W マーカー用ファイバレーザ



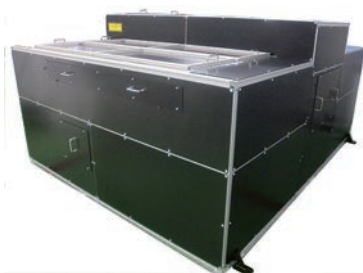
NuQ 50Wは高繰返しパルスファイバレーザ光源(平均出力50W)である。パルス波形がスムーズでピーク出力10kWが達成されている。多種多様な材料に視認性の良いレーザマーキングが可能。また、太陽電池基板のスクライビングやトリミング、エッチング、エンレービングなど多様な利用分野

で実績がある。赤色ポイントオプションあり。また、出力ビームの径は1.0～12.0mmの5種類から選択可能。

LaserTech2013にて本製品と3Dガルバノスキャナと組み合わせたライブデモンストレーションを予定している。

株式会社オプトサイエンス  
☎03-3356-1064  
ブース番号:T-068

### 高速レーザスキャニングシステム



カワサキ高速レーザスキャニングシステムは、レーザを超高速で広域に同品質で照射することが可能。レーザ照射ユニットは、様々な種類のレーザ用にカスタマイズでき、ワーク通過型のシステムとして構築することで、アプリケーションの高生産性に貢献できる。本装置の特徴はワーク通過型システム、超高速スキャニング、走査域が広く垂直なレーザ走査、幅が均一で細かい加工線など。

川崎重工業株式会社  
プラント・環境カンパニー  
☎078-682-5411 出展ブース:T-048

### 狭線幅レーザ

米RIO社の新しい1064nm帯レーザ、C-band、L-band帯の波長可変レーザ。1550um帯、2W出力の従来品と合わせ非常に高い実績を得ている。DFBレーザと比べ、外部共振型レーザの共振器長が長いので、狭い線幅と低周波ノイズを得ることができる。また高



い安定性と信頼性を持ち、ファイバセンシングやガス検知など幅広いアプリケーションに適應。1550nm帯レーザ、1064nm帯レーザ共にデモ機を用意。購入前の試用も可能。

日本デバイス株式会社 営業部  
☎03-3832-3555  
ブース番号:T-074

### レーザー微細加工装置



ベルギー Optec社のナノ／ピコ／フェムト秒パルスレーザから、加工用途に最適なパルス幅と波長のレーザを複数搭載することのできる新しいモデル(MM200-USP)。筐体にはスチールフレームを使用し、加工テーブルと光学系は頑強なグラナイト台に固定して加工精度を確保している。同軸リアルタイム観察モニターに強力なズームカメラを追加して、操作ソフトウェアに組み込まれているモニターから位置の確認調整、加工状態の観察など視覚的な操作を大幅に向上させた。

ビーム株式会社 営業部  
☎042-797-4141  
出展ブース:T-073